格科微有限公司 关于与国家开发银行等金融机构签署贷款合同 的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格科微有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月26日召开第一届董事 会第十六次会议、2022年6月23日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于 2022年度申请综合授信额度的议案》,批准公司2022年度的授信额度,其中含公 司(包括公司及公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)向国家开发银 行上海市分行等银行申请不超过35亿元的银团贷款用于"12英寸CIS集成电路特 色工艺研发与产业化项目"。

近日, 公司子公司格科半导体(上海)有限公司与国家开发银行上海市分行 牵头组成的贷款银团签署了《12英寸CIS集成电路特色工艺研发及产业化项目(一 期)人民币资金银团贷款合同》,贷款总额为35亿元人民币,贷款期限为2022年 9月19日至2032年9月18日,贷款用途为用于"12英寸CIS集成电路特色工艺研发 与产业化项目(一期)"。公司将严格遵照股东大会批准的议案,履行该协议。

公司本次签署贷款合同是基于公司实际经营情况的需要, 符合公司结构化融 资安排,能够更好地支持公司业务活动的开展。公司目前经营状况良好,具备较 好的偿债能力,本事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

特此公告。

格科微有限公司董事会 2022年9月27日